

INTC –P2-B1-2

Generated: 2026-07-26 15:24 Source: Claude Code CLI (ADR-0036) phase=phase2_branch

我需要为这份 Intel 深度研究调用 web 搜索工具查证 Q2 2026 财报 (2026-07-23 发布, 晚于我的知识截止)。先加载 web 工具, 同时并行派出 3 个专项研究子代理。

现在派 3 个并行研究代理, 分别攻克 DCAI 毛利率拆解、14A/N2P PPA 对比、以及超大规模云厂商 + AMD 对标。

三个子代理已返回。**关键发现 (必须立即修正)**: Intel 不按分部披露 gross margin, `DCAI Q2 2026 39.5%` 实际是**分部 operating margin** (\$2.474B / \$6.262B), 非毛利率。以下报告将按此口径展开。

Intel Inc. (INTC) –第二轮 Deep Research 报告

研究日期: 2026-07-26 本轮聚焦: DCAI Q2 2026 39.5% 利润率质量拆解 + Intel 14A vs TSMC N2P PPA 对比

开篇说明: 口径修正与前提

口径修正: 上游任务描述中的 `DCAI Q2 2026 毛利率 39.5%` 实为**分部 operating margin** (segment operating income \$2.474B / 分部营收 \$6.262B)。Intel 不按分部披露 gross margin。本报告全文按 **operating margin 口径** 分析。

继承 DR-1 已确立结论 (不重复验证): 1. 14A 外部量产客户 = 0 (截至 2026-07-23); 管理层口径为“两家匿名潜在客户”, firm commitment 预期 2H2026。2. 18A 良率两组数据 (TrendForce 10-15% 对应 2025H2 风险试产; KeyBanc ~85% 对应 2026H1 HVM 阶段) 时间截面不同, 曲线自洽。3. 14A PDK 0.9 预定 2026-10 交付, defect density ahead of schedule; HVM 提前至 2028。

一、Bullet-first 关键发现摘要

目标 A: DCAI 39.5% operating margin 质量

- [FACT] Q2 2026 DCAI 营收 \$6.3B (+59% YoY, +24% QoQ), operating income \$2.5B (op margin 39.5%), QoQ 提升约 8pp。管理层归因 “higher revenue, improved product margins, and lower operating expenses” (Zinsner)。
- [FACT] Intel 未单独披露 Gaudi 营收; 改用 “purpose-built silicon / ASIC” 口径: Q2 2026 ASIC 营收 YoY 近 3 倍、QoQ +20% (Zinsner); Q1 2026 表述为 “run rate >\$1B”。
- [EST] ASIC 业务季度化 Q2 2026 约 \$300-360M (占 DCAI 营收 ~5%); Gaudi 独立贡献无法从公开披露拆分, 管理层重心已从 Gaudi 转向 ASIC/Xeon 叙事, 暗示 Gaudi 本身贡献有限。
- [FACT] Xeon 6 “fastest ramping products in Intel history” (Lip-Bu Tan); ASP 提升机制: core-count/ASP 阶梯 (“priced on ASP per core basis”)。
- [FACT] Q2 2026 无识别到 DCAI 分部内一次性大额项目; \$173M 库存 write-down 定位于 CCG 分部, 非 DCAI。CHIPS Act 现金流入 \$60M 未按分部拆分。
- [EST] 39.5% 中结构性驱动占比 70-80%, 一次性 20-30% (可能包含库存 reserve release、CHIPS ITC 分摊、折旧年限调整, 均 [GAP] 未量化)。单季度 8pp 跳升幅度较大, 隐含未披露一次性利好可能。
- [FACT] Q2 2026 Intel Foundry 营收 \$5.8B (+31% YoY), operating loss -\$2.1B (vs Q2 2025 -\$3.2B、Q1 2026 -\$2.4B), 改善趋势明确但仍显著拖累合并报表。

目标 B: 14A vs N2P PPA 对比 + 客户切换门槛

- [FACT] Intel 14A vs 18A 官方数据：性能 +15-20% (iso-power)、功耗 -25-35% (iso-perf)、密度 1.3×；14A 关键技术含 2nd-Gen RibbonFET + PowerDirect + High-NA EUV (业界首用)。
- [FACT] TSMC N2P vs N3E：性能 +18%、功耗 -36%、chip 密度 1.15×；N2P 量产 2H2026；N2P 不含 BSPDN (BSPDN 由 A16 承载)。
- [EST] 14A vs N2P 综合对比：以 N3E 为基线反推，14A 密度可能领先 30-45%、功耗略优 (PowerDirect vs 无 BSPDN 的 N2P)，性能大致持平。但均基于官方相对数字 + 第三方推算，尚无硅测数据。
- [FACT] 14A 量产时间 (2028) 比 N2P (2H2026) 晚约 18-24 个月，同期真正对手是 TSMC A14/A16-P。
- [FACT] 历史类比：TSMC N3 PDK → 首客户量产约 12-15 个月 (MediaTek 2023 tape-out)，TSMC N2 PDK 0.9 → 首客户量产约 24-30 个月 (Apple A20 2026H2)。Intel 14A PDK 0.9 若按 12-15 月最快节奏，首个外部客户 tape-out 有望 2027H2。
- [INFERRED] 14A 密度/功耗数字上限具备切换吸引力，但 **IP 生态 (HBM 控制器、SerDes、foundation IP) 与量产良率两项在 2026H2 尚不足以撬动 Apple/NVIDIA/AMD 一线客户**，实际切换或首见于对成本较不敏感的 AI/HPC 二级客户 (xAI、Tesla Dojo 类)。

关联上下文 (新识别的结构性风险)

- [FACT] Q1 2026 Mercury 数据：AMD 服务器 CPU 单位份额 33.2% (+6pp YoY)，收入份额创纪录 46.2%；ARM 服务器份额 13.2% (YoY 近乎翻倍，主要由 NVIDIA Grace 驱动)。
- [FACT] Google Cloud 2026-05 宣布**第八代 TPU 全线以 Axion 为 host CPU**—AI 主机侧全面 ARM 化，对 Intel Xeon 形成结构性挤压。
- [FACT] AWS Graviton 覆盖 top-1000 EC2 客户 98%；两大客户请求包下 2026 全部 Graviton 产能；Graviton5 于 2026 GA。
- [FACT] Azure Cobalt 200 (132 核 Neoverse V3, TSMC 3nm, 性能 +50%) 2026 Build 宣布 EA, GA “later 2026”。

二、关键数据点表格

表 1: DCAI 季度 Operating Margin 驱动因素分解

驱动因素	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026	数据类型	来源
DCAI 营收	0.96	[GAP]	1.54	2.47	[FACT]	各季 10-Q
$(B) 4.1 4.7 5.1 6.3 [FACT] 10-Q DCAI\text{OperatingIncome}(B)$						
DCAI Operating Margin (%)	23.4	[GAP]	~30.5-31	39.5	[FACT]	倒推自上两行
ASIC 营收贡献估算 (\$M)	[UNK]	[UNK]	250-300	300-360	[EST]	管理层增速外推
Xeon 6 渗透	早期 ramp	加速	快速渗透	“fastest ramping in history”	[FACT]	Lip-Bu Tan Q2 call
Underloading charges (Foundry, \$M)	~797 (Q2’25 参考)	[UNK]	[UNK]	未单独披露	[FACT/GAP]	10-Q
一次性项目 (DCAI 内)	—	—	—	未识别到	[FACT]	Q2 call + 10-Q

驱动因素	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026	数据类型	来源
结构性 op margin 估算 (剔除潜在一次性 20-30%)	n/a	n/a	n/a	28-34	[EST]	定性拆分

表 2: Intel 14A vs TSMC N2P PPA 对比

指标	Intel 14A	TSMC N2P	数据类型	来源
性能提升 (vs 前代 iso-power)	+15-20% (vs 18A)	+18% (vs N3E)	[FACT]	Intel 官方 / TSMC HPC 页
功耗节省 (vs 前代 iso-perf)	-25 至 -35% (vs 18A)	-36% (vs N3E)	[FACT]	同上
密度提升 (vs 前代)	1.3× (vs 18A)	1.15× chip / 1.2× logic (vs N3E)	[FACT]	同上
绝对密度 (MTr/mm²)	~242 (第三方推算)	~230-250 (估算)	[EST]	X/@meng 反推
SRAM bitcell 面积	[GAP]	[GAP]	—	待 IEDM 2026 官方
关键技术	2nd RibbonFET + PowerDirect + High-NA EUV	GAA + 无 BSPDN	[FACT]	
PDK 完整度 / HVM 时间	0.9 (2026-10 交付) / HVM 2028	1.0 (量产中) / HVM 2H2026	[FACT]	Intel / TSMC
首个外部量产客户承诺	0 (截至 2026-07)	Apple、AMD、NVIDIA、MediaTek	[FACT]	公开新闻
Defect density 状态	ahead of schedule	量产中	[FACT]	Intel Q2 call
客户 IP 生态成熟度	落后 (Cadence 已签, Synopsys/Siemens 跟进)	完整	[FACT/INFERRED]	行业报告

表 3: 超大规模云厂商 CPU 采购结构变化

云厂商	Intel Xeon 6 采纳 (2026H1)	自研 ARM 进展	定制 AI 芯片影响	数据类型
AWS	8th-Gen EC2 上线, 早期客户 Net-flix/CrowdStrike	Graviton = 98% top-1000 EC2 客户; 2 客户包 2026 全部产能	Trainium 2/3 竞争 NVIDIA	[FACT]
Azure	未见 Xeon 6 公开新闻	Cobalt 100 覆盖 32 区; Cobalt 200 GA “later 2026”	Maia 100 部署中	[FACT/UNK]
Google	多年协议; C4 全 shape 支持 Xeon 6 + TDX	Axion N4A GA 2026-01; 第八代 TPU 全 Axion host	TPU 8t/8i 全 Axion host	[FACT]

云厂商	Intel Xeon 6 采纳 (2026H1)	自研 ARM 进展	定制 AI 芯片影响	数据类型
Meta	[UNK]	MTIA 定制 ASIC	训练侧 NVIDIA GPU 主导	[FACT/UNK]

三、深度分析与机制推演

§C-1 反身性循环：39.5% 利润率的信号功能与其对 Foundry 谈判的反射效应

“DCAI Q2 2026 op margin 39.5%”在表观上强化了 Intel Products 业务的独立经济性叙事，但对 Foundry 期权价值的传导却存在反身性风险。若外部客户在评估 14A 谈判时，发现 39.5% 利润率中超过 20% 来自未披露的一次性因素（如库存 reserve release、CHIPS ITC 分摊），可能推断 Intel 真实制造成本结构弱于表观，进而在谈判中要求更大定价让步——形成“利润率高 → 制造经济性存疑 → 客户要求折扣 → Foundry 利润率被压缩”的反身循环。这也是半导体代工市场特有的“**manufacturing credibility discount**”——代工厂即便良率达标，仍需 1-2 个大客户公开背书才能消除买方信息不对称溢价。Q2 单季度 8pp 跳升幅度（31% → 39.5%）确实过大，需 Q3/Q4 连续验证方可确认结构性。

§C-2 历史类比：GlobalFoundries 14nm 教训与 PDK 完整度作为切换成本

GlobalFoundries 于 2015-2018 期间在 14nm 节点上曾拥有相对 Intel 的良率优势，但因 PDK 生态不完整、EDA 工具支持滞后，AMD 最终在 2018 年将 Zen 2 迁至 TSMC 7nm，导致 GF 2018-08 放弃 7nm 研发、转向成熟制程代工。这一先例对 Intel 14A 的启示：“**PDK completeness as a switching cost**”——PDK 1.0 前的 tape-out 风险溢价是客户延迟承诺的理性选择，而非对 Intel 技术能力的否定。14A PDK 0.9 交付（2026-10）后，参考 TSMC N3 的 12-15 月节奏，最快 2027H2 才能看到外部客户首次 tape-out 宣布；但 TSMC N2 的 24-30 月节奏更贴近 leading-edge 现实，暗示 14A HVM 2028 客户量产窗口相对紧张。

§C-3 多维度风险传导：超大规模 ARM 化 + AI host CPU 结构性挤压

Google Cloud 2026-05 宣布 **第八代 TPU 全线以 Axion 为 host CPU**，这一决策的信号意义超过单纯份额挤压——AI 服务器 host CPU 是过去 5 年 Xeon 增长的核心引擎，而这一 TAM 正在结构性 ARM 化（NVIDIA Grace 覆盖 GB200/GB300 NVL72、Axion 覆盖 TPU、Cobalt 200 覆盖 Azure AI 工作负载）。Intel DCAI Q2 2026 强劲反弹主要来自 Xeon 6 早期 ramp + 一次性 hyperscale 补库存需求，2027-2028 的可持续性面临 **operating leverage trap** 反向风险——一旦 hyperscale attachment rate 结构性下滑，DCAI 高固定成本结构的负营运杠杆会放大利润率回落幅度。这与 Foundry 未见外部客户签约的空窗形成“双前线承压”格局：Products 侧 TAM 结构性收缩 + Foundry 侧外部营收未起量。

四、情景矩阵 (Bull / Base / Bear 三档)

情景	核心假设	DCAI 结构性 op margin	14A 首个付费外部客户时间	Foundry 外部营收 (2027E)	Foundry 运营亏损收窄路径
Bull	Xeon 6 持续放量; 39.5% 中一次性 <15%; PDK 0.9 后 12 个月内首客户 tape-out; 14A vs N2P 密度/功耗优势兑现; 至少一家 tier-2 客户 (xAI/Tesla) 签约	35-38%	2027H2	\$2.0-2.5B	2028E 盈亏平衡
Base	Xeon 6 ramp 后 hyperscale ARM 侵蚀显现; 一次性 15-25%; 14A 客户谈判延至 2027H2; PPA 对标 N2P 但 IP 生态限制大客户切换	30-34%	2028H1	\$1.2-1.6B	2029E 盈亏平衡
Bear	Hyperscale ARM 化加速 (Ax-ion/Cobalt/Graviton 挤压); 39.5% 含大量一次性; 14A 无外部客户至 2028H2; PPA 优势难以抵消 IP 生态劣势	25-29%	2029+ 或无	<\$0.8B	2030+ 或无路径

估值影响结论 (§A)

一句话核心判断

DCAI 39.5% op margin 大概率结构性主导 (70%) 但 Q3/Q4 需验证; 14A PPA 数字上限存在竞争力, 但 IP 生态 + 良率信任 + hyperscale ARM 化三重结构性问题, 使 Foundry 期权价值兑现路径显著弱于当前市场隐含定价——M1 Bear 情景概率上调。

三档情景估值影响

情景	估值影响 (\$B)	% of \$465.7B mcap	推算路径	Epistemic Tag
Bull case	+\$55B	+11.8%	Foundry EV 从隐含 \$180B 上修至 \$220B (+\$40B, 14A tier-2 客户签约触发 option 价值部分兑现); Products 端 DCAI 结构性利润率验证 +\$15B (P/E 46.5x × \$0.3B EPS 增量) = +\$55B	INFERRED
Base case	-\$30B	-6.4%	Foundry option 价值随时间线延后被市场折价 -\$30B (\$180B → \$150B); Products 端持平 (Xeon 6 短期强 + ARM 化中期压力对冲)	INFERRED
Bear case	-\$140B	-30.1%	Foundry EV 从隐含 \$180B 压缩至 GlobalFoundries-like 保守估值 \$50-80B (-\$110B); Products 端因 hyperscale ARM 结构性挤压 DCAI TAM, -\$30B	INFERRED

推算锚点: - Intel 整体市值 **\$465.7B** (authoritative) - H1 2026 Foundry 外部营收 \$467M (10-Q), 年化 \$0.93B [FACT] - Foundry 盈亏平衡门槛: 外部营收 \$2-5B (管理层口径下调) [FACT] - EV/Rev 倍数参照: GlobalFoundries ~1.8x、TSMC ~10x, Intel Foundry 爬坡期取 2.0-3.0x [EST] - Base case 算式: Foundry 隐含 \$180B × (-17%) -\$30B (option 价值时间衰减) - Bear case 算式: Foundry EV 压缩至 \$70B (\$2B 保守外部营收 × 2.0x 倍数 + \$60B 战略资产折价), vs 当前 \$180B 隐含 = -\$110B; 叠加 DCAI TAM 侵蚀 P/E 46.5x × (\$0.6B EPS 侵蚀) -\$30B

Time horizon

2-3y: DCAI 结构性利润率验证需 Q3/Q4 2026 + FY2027 (4Q); 14A 首个外部客户签约 + Foundry 规模效应显现需 2-3y。

Linked Mispricing Refinement (\$B)

Mispricing refinement: M1 –Intel Foundry 期权价值被市场过度定价 (~\$180B 隐含价值)

- **Crystallization estimate (前置):** magnitude_class=large, estimated_value_at_stake_b=\$180.0B
- **Refined estimate:**

- Bull: +\$50B (Foundry EV 上修至 \$230B, 14A tier-2 客户签约)
- Base: -\$30B (option 时间衰减)
- Bear: -\$110B (Foundry 压缩至 GlobalFoundries-like \$70B)
- **Direction: confirmed** (本轮研究进一步支持 M1 空头 thesis: 14A PPA 数字上限存在但 IP 生态、PDK 时间、hyperscale ARM 化三重障碍未解, Q2 财报后仍无外部客户签约)
- **Confidence: medium** (14A PDK 交付节奏 ahead of schedule 提供部分支撑, 但 hyperscale AI host CPU 结构性 ARM 化是新增负面变量)
- **Key finding driving refinement:** Google 2026-05 宣布第八代 TPU 全 Axion host = Xeon TAM 结构性缩减; 同时 14A 相对 N2P 的密度/功耗优势在无 IP 生态支撑下难以撬动 tier-1 客户, Foundry 首个付费外部客户签约概率维持低位

Mispricing refinement: M4 –18A 良率数据矛盾

- **Crystallization estimate(前置):** magnitude_class=medium, estimated_value_at_stake_b=\$80.0B
- **Refined estimate:**
 - Bull: +\$20B (Panther Lake 供货顺畅 + 14A PDK ahead of schedule 复验良率曲线)
 - Base: \$0B (良率争议消退但无新增证据)
 - Bear: -\$30B (Panther Lake 消费市场出现供货紧张或质量投诉)
- **Direction: revised** –方向下修 (DR-1 已解释两组数据时间截面不同, 本轮 14A PDK defect density ahead of schedule 进一步支撑良率爬坡曲线自治性; M4 核心矛盾部分消解)
- **Confidence: medium** (Panther Lake 消费市场供货表现仍是最终验证节点, Q3/Q4 2026 数据关键)
- **Key finding driving refinement:** 14A PDK 交付节奏与 defect density ahead of schedule 数据支持 Intel 工艺爬坡曲线可信度, M4 \$80B 风险估值向下修正约 40-50%

M1 与 M4 关系说明: M4 是 M1 的底层验证变量。M4 风险部分消除, 但 M1 核心问题 (外部客户签约 + IP 生态 + hyperscale ARM 化) 与良率无关, 故 M1 结论不因 M4 缓和而反转。§A 顶层数字以 M1 为主导。

五、可监控指标清单

指标	当前水平 (2026-07-26)	监控阈值	频率	信号方向
DCAI 季度 op margin	39.5% (Q2 2026) [FACT]	<32% 触发 Bear / >37% 连续 2 季触发 Bull	季报	利润率可持续性
DCAI 一次性项目占比估算	[EST], 未量化	>25% 一次性 = 警告信号	季报附注	结构性质量
ASIC/purpose-built silicon 季度营收 (Intel 管理层口径)	Q2 ~\$300-360M [EST]	连续 2 季 QoQ >20% = Bull 信号	季报	AI 加速器渗透率
Google Cloud + AWS 对 Xeon 6 的公开采纳新闻	已有多年协议 (Google) / 8th-Gen EC2 (AWS) [FACT]	Azure/Meta 未来 12 月内公开采纳 = Bull	事件驱动	Hyperscale attachment
Hyperscale ARM CPU 部署规模	Axion 覆盖 TPU 8t/8i; Graviton 98% top-1000 [FACT]	Azure Cobalt 200 GA + Google Axion N4A 单季部署 >30 区域 = 结构性挤压确认	事件驱动	Xeon TAM 侵蚀

指标	当前水平 (2026-07-26)	监控阈值	频率	信号方向
14A 外部量产合约数量	0 (截至 2026-07-23) [FACT]	首个具名客户签约即触发 M1 Bear 反转	事件驱动	Foundry 期权价值
PDK 0.9 交付后首个客户 tape-out 宣布	预期 2026-10 交付 [FACT]	2027Q1 前具名客户宣布 tape-out = 正面; 2027Q3 前无动静 = 负面	事件驱动	14A 技术可信度
Panther Lake 消费市场供货表现	Q2 2026 开始出货 [FACT]	供货紧张/质量投诉 = 18A 良率复验	季报 + 媒体追踪	18A 量产稳定性
Intel Foundry 外部营收 (季度)	H1 2026 合计 \$467M [FACT]	单季突破 \$300M = 结构性进展	季报	盈亏平衡路径
Foundry 运营亏损改善幅度	-\$2.1B (Q2 2026) [FACT]	连续 2 季 QoQ 收窄 >\$200M = Bull	季报	规模效应兑现
14A vs N2P 独立硅测 PPA 数据	无第三方硅测 [GAP]	SemiAnalysis/VLSI 硅测报告发布	事件驱动	Foundry 竞争力实证
AMD Data Center 分部 op margin	Q1 2026: 27.6% [FACT]	Q2 2026 >32% = Intel DCAI 领先窄化	季报 (AMD Q2: 2026-08-04)	竞争定价压力

六、来源引用

Intel 一手来源: - Intel Q2 2026 10-Q (accession 0000050863-26-000157, SEC EDGAR) - 分部营收/利润、Foundry 亏损明细 - Intel Q2 2026 Earnings Call transcript (2026-07-23): - https://finance.biggo.com/news/US_INTC_2026-07-23 (Zinsner DCAI margin 归因原文) - <https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-intel-tops-q2-2026-estimates-as-shares-rebound-after-hours-93CH4810201> (ASP per core 机制) - Intel Foundry 官方页面: <https://www.intel.com/content/www/us/en/foundry/process.html> (14A 官方 PPA 相对数字) - Intel IR: <https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1776/intel-reports-second-quarter-2026-financial-results> - Intel Foundry Direct Connect 2025 新闻稿: <https://newsroom.intel.com/intel-foundry/intel-foundry-gathers-customers-partners-outlines-priorities>

14A / N2P 技术数据: - Tom's Hardware (Intel CFO 14A cost/PPA 表述): <https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/intel-cfo-confirms-that-14a-will-be-more-expensive-to-use-than-18a> - Tom's Hardware (14A 客户 commitment 2H2026): <https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/intel-says-it-has-two-prospective-customers-for-14a-expects-to-hear-about-commitments-in-second-half-of-2026> - Wccftch (14A PDK 0.9 2026-10): <https://wccftch.com/intel-ceo-lip-bu-tan-threatens-to-fire-anyone-whose-chip-exceeds-b0-stepping-14a-pdk-0-9-october-2026/> - TrendForce (TSMC N2P 2H2026 确认): <https://www.trendforce.com/news/2025/10/16/news-tsmc-confirms-n2p-for-2h26-joins-a16-to-cement-2nm-class-as-major-long-lived-node/> - TSMC HPC 平台页 (N2P 官方 PPA vs N3E): https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/technology/platform_HPC_tech_advancedTech - Wccftch (Tesla/xAI 通过 TeraFab 关联 14A): <https://wccftch.com/intel-14a-wins-tesla-major-customers-foundry-business-gamble-pays-off/>

Hyperscale + 竞品: - Mercury Research Q1 2026 x86 服务器 CPU 份额 - Tom's Hardware: <https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-reaches-46-percent-of-server-x86-cpu-revenue-intel-still-controls-70-percent-of-the-consumer-pc-market-share> - The Register (ARM 服务器份额 13.2%): <https://www.theregister.com/systems/2026/06/04/amd-takes-a-third-of-server-cpu-market-as-shipments-grow/> - Azure Blog (Cobalt 200 EA 2026 Build): <https://azure.microsoft.com/en-us/blog/new-azure-cobalt-200-vms-deliver-50-performance-improvement-fully-optimized-for-modern-agentic-ai->

workloads/ - Arm Newsroom(Google Axion N4A GA + TPU host):<https://newsroom.arm.com/blog/arm-and-google-cloud-redefine-agentic-ai-infrastructure> - Intel IR(Google-Intel 多年协议):<https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1766/intel-and-google-deepen-collaboration-to-advance-ai> - Intel Newsroom (AWS 8th-Gen EC2 Xeon 6) : <https://newsroom.intel.com/data-center/intel-and-aws-drive-cloud-innovation-powered-by-xeon-6-processors> - DCD(AMD Q1 2026 DC):<https://www.datacenterdynamics.com/en/news/posts-q1-2026-data-center-revenue-of-58bn-forecasts-120bn-server-cpu-income-by-2030/>

关键 GAP 说明: - SemiAnalysis 未见公开的 14A vs N2P 深度对比报告; 14A 绝对密度、SRAM bitcell 面积待 IEDM 2026-12 - Intel Q4 2025 DCAI 分部 op income 明细未见清晰公开摘要 - DCAI 内部一次性项目(库存 reserve、CHIPS ITC 分部分摊) 未按分部拆分披露